



德州仪器最新TMS320C66x 多内核DSP

— DSP 培训课件之十

上海交大-TI 联合DSP实验室 版权所有



● 作为高端DSP领域的霸主,据TI的最新报道, 其多内核 DSP 核心器件的 TMS320C66x DSP 内核实现了前所未有的性能突破,频率已高达 1.5 GHz,远远超越了业界任何其他 DSP 的性 能。





TI DSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000,C2000,C5000,达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP ,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例:
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设;
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Boot loader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236 (牛老师),

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn , niujinhai@yahoo.com.cn.







颁发TI授权的培训证书





多核DSP的特点与优势

| 特性 | 客户优势 |
|---|--|
| 高性能: 多个速率高达 1.25 GHz 的高性能 DSP,每周期定点性能高达 32 MAC,每周期浮点性能高达 16 FLOP; | 使用户能够整合多个 DSP, 节省板级空间, 降低成本, 并降低整体电源需求; |
| 高集成: 每个 DSP 内核都集成定点与浮点处理功能; | 可改进计算密集型算法的性能,与分别在定点及浮点器件上进行软件开发相比,其可大幅缩短开发时间,能够将所需时间从数月锐减至几天; |
| 低功耗:针对所有应用的低功耗,充分利用 TI 突破性低功耗 SmartReflex™ 技术,并可根据环境条件动态调节电源电压; | 支持更低功耗的系统设计,并可在给定 功率预算内实现更高的处理功能; |



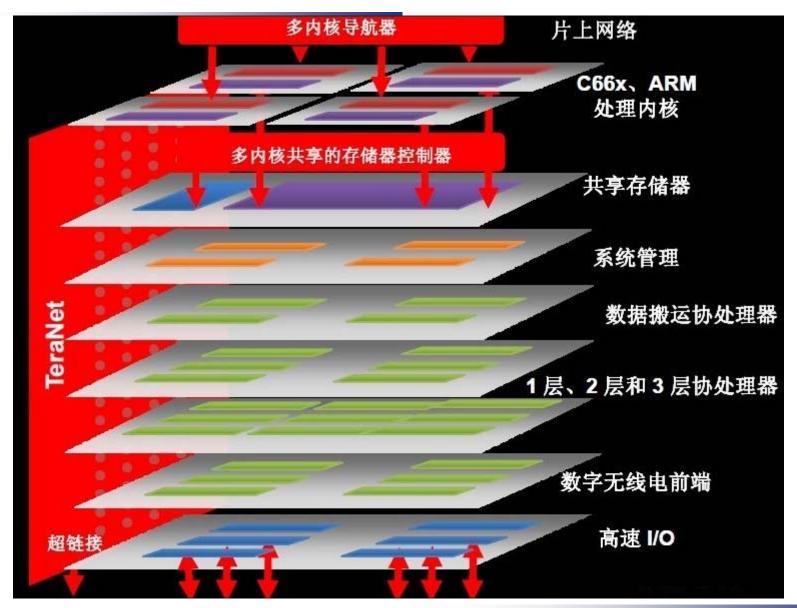
多核DSP的特点与优势

| 特性 | 客户优势 |
|--|--|
| 多内核特性:最新梯形构包括多内核导航、改进的存储器架构、超链接接口、PCI Express Gen 2、Serial RapidIO 以及其它外设等丰富的特性,可实现内核与存储器存取的直接通信,并可充分发挥多内核性能; | 使设计人员能够全面使用 DSP 内核、外设以及协处理器,因此可减少给定应用所需的 DSP 数量,从而可降低成本; |
| 工具与软件: 完整的软硬件支持,不但包括 Linux 操作系统、BIOS、多内核平台软件、开放式 GCC 工具、Code Composer Studio™ 软件与 MC-SDK,而且还可提供 C 编译程序、专用软件库与演示; | 可缩短设计周期,简化开发; |
| 可扩展性: 全系列多内核器件的引脚兼容, 并与 TI 现有 C6000 DSP 实现了软件兼容。 | 可在统一产品平台上进行开发,实现多种不同产品的扩展,使客户能够重复使用TI DSP 上正在运行的现有软件。 |





TI的梯形多核架构



U1

guoyang, 2011-9-18



梯形多内核架构不但可最大限度地提高片上数据流的吞吐量,而且还可消除可能出现的瓶颈问题,释放了多内核的强大功能,在性能、精度、低功耗、实时、简易性和高容量等方面,打破了"不能兼得"的局面,使C66x系列的产品为创新与性能设立了新的标准。



TMS320C66x DSP系列芯片

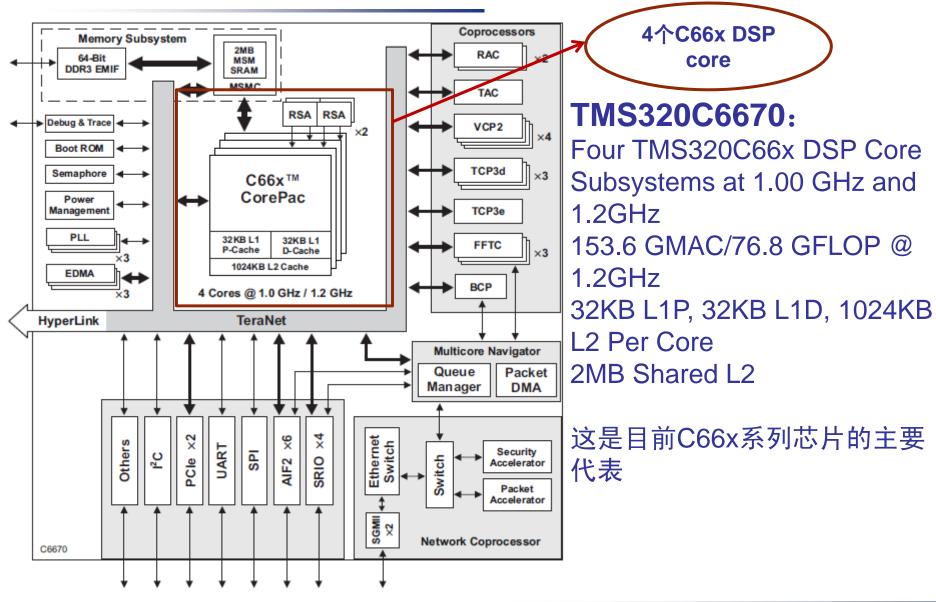
TMS320C66x有2核、4核、8核,可以供不同应用场合使用,并且管脚兼容。每个内核都同时具备定点与浮点运算能力,并且都有40个GMAC 1.25GHz,20个GFLOP 1.25 GHz,其性能是市场上已发布多内核DSP的5倍,特别是8核TMS320C6678运行速率能达到10 GHz。TMS320C66x具有低功耗与大容量,采用TI Green Power技术构架,动态电源监控和SmartReflex技术。



TMS320C66x DSP系列芯片

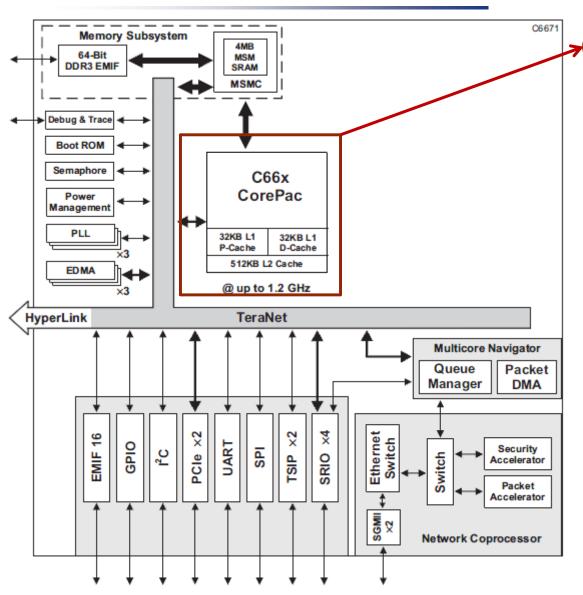
| 芯片型号 | CPU | Peak MMACS | Freque ncy (MHz) | On-Chip L1/SRAM | On-Chip L2/SRA M | Timers |
|-----------------|--------|---------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| TMS320C 6670 | 4 C66x | 153000 | 1000 1200 | 256 KB (32 KB Data, 32 KB Program per core) | 6144 KB (2048 KB Shared) | 8 64-Bit |
| TMS320C 6671 | 1 C66x | 40000 | 1000 1250 | 64 KB (32 KB Data, 32 KB Program) | 4608 KB (4096 KB Shared) | 9 64-Bit |
| TMS320C 6672 | 2 C66x | 80000 | 1000 1250 | 128 KB (32 KB Data, 32 KB Program per core) | 5120 KB (4096 KB Shared) | 10 64-Bit |
| TMS320C 6674 | 4 C66x | 160000 | 1000 1250 | 256 KB (32 KB Data, 32 KB Program per core) | 6144 KB (4096 KB Shared) | 12 64-Bit |
| TMS320C 6678 | 8 C66x | 320000 | 1000 1250 | 512 KB (32 KB Data, 32 KB Program per core) | 8192 KB (4096 KB Shared) | 16 64-Bit |







上海交通大學多核定点和浮点数字信号处理器 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

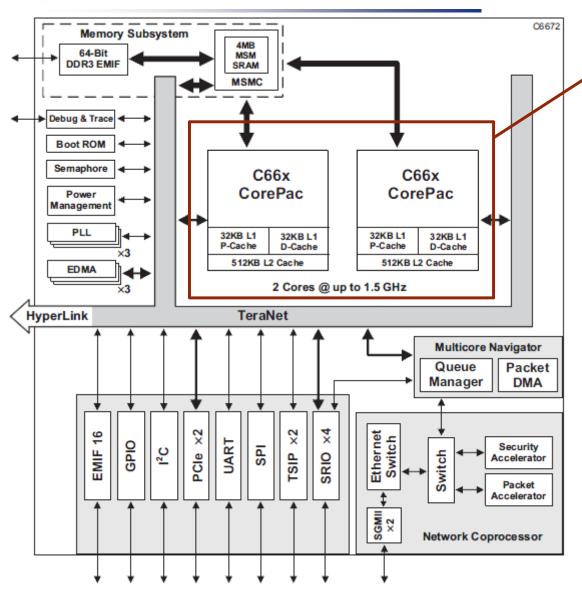


1个C66x DSP core

TMS320C6671:

One TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz 40 GMAC/20 GFLOP @ 1.2GHz 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2 1 MB Shared L2 这款芯片是C66x系列的基本 框架结构,内部只有一个 C66x DSPcore



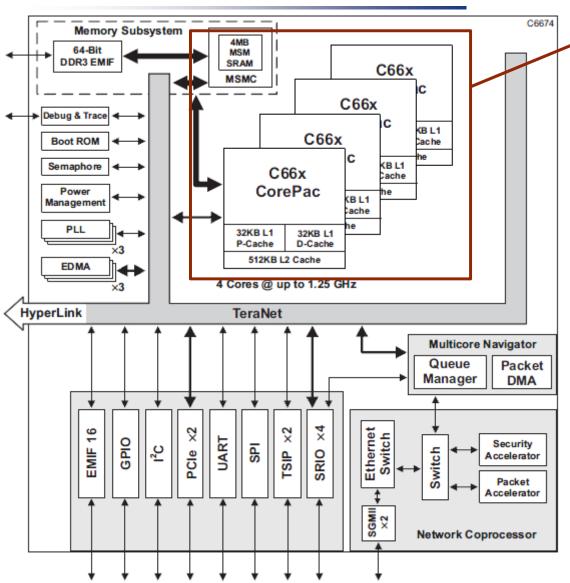


2个C66x DSP core

TMS320C6672:

Two TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz 80 GMAC/40 GFLOP @ 1.2GHz 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2 Per Core 2 MB Shared L2 这款芯片是在C66x系列的基 本框架结构下内部集成了两 个C66x DSPcore



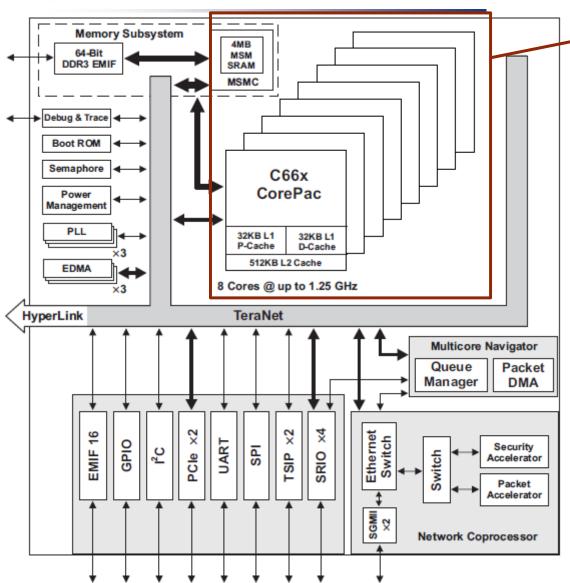


4个C66x DSP core

TMS320C6674:

Four TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz 160 GMAC/40 GFLOP @ 1.2GHz 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2 Per Core 4MB Shared L2 这款芯片是在C66x系列的基 本框架结构下内部集成了4个 C66x DSPcore





8个C66x DSP core

TMS320C6678:

Eight TMS320C66x DSP Core Subsystems at 1.00 GHz and 1.25GHz 320 GMAC/160 GFLOP @ 1.25GHz 32KB L1P, 32KB L1D, 512KB L2 Per Core 4MB Shared L2 这款芯片是在C66x系列的基 本框架结构下内部集成了8个 C66x DSPcore



上海交通大學 C667X系列多核DSP与FPGA的比较

| C667X的优势 | C667X厂商的优势 |
|-----------|---------------------|
| 浮点性能 | 影像、媒体、自动化 |
| 高灵活性/可编程性 | 简化复杂的算法部署 |
| 电源效率 | 每MHz/GMAC/GFLOP功耗最低 |
| 低成本 | 多内核DSP,售价不足100美元 |



多核DSP的典型应用展望

TMS320C66x目标应用领域有关键任务、测试与自动化、 医疗影像、智能电网、新型宽带以及高性能计算等。

例如,医疗电子有几个热门的方向:彩色超声波、用于引导手术的实时透视、超声波便携式设备、内窥镜等, C667x DSP凭借其实时处理、便携式、低功耗、可编程性、高性能的优势,能够立即实现这些医疗应用。





TI DSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000,C2000,C5000,达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP ,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例:
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设;
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Boot loader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236 (牛老师),

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn , niujinhai@yahoo.com.cn。







颁发TI授权的培训证书









谢 谢!

